

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终践行“以投资者为本”的理念，立足于维护公司全体股东的利益，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于 2025 年 4 月制定并积极贯彻落实《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，围绕经营质效、公司治理、信息披露及投资者回报等方面持续开展工作。

为进一步提升公司质量和投资价值，公司结合实际情况，编制了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司将持续优化经营管理，提升治理水平和规范运作能力，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。具体内容如下：

### 一、 聚焦经营主业，提升经营质量

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，公司主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 以及更高速率的 DFB、EML 激光器系列产品和 50mW、70mW、100mW 等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，公司产品涵盖 1550 波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

通过持续的研发投入构建差异化竞争优势，公司从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展成为国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片

供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

2025 年，公司实现营业收入 60,143.45 万元，同比增加 138.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,092.40 万元，同比扭亏为盈。公司的电信市场业务实现收入 20,646.96 万元，较上年同期增加 2.06%。公司的数据中心业务实现收入 39,325.78 万元，较上年同期上升 719.06%。

2026 年，公司将继续聚焦主营业务，持续加大研发投入，提升核心竞争力；同时，加强人才队伍建设，为公司发展注入动力。在项目推进方面，公司将加快募投项目的建设，提升生产制造水平，确保产品质量和交付能力。市场拓展上，加强重点客户拓展，积极推进海外市场布局，进一步提升公司在全球市场的份额和影响力。具体措施如下：

### **1、持续加大研发投入，提升核心竞争力**

2025 年，公司持续保持较高研发投入水平，全年研发支出 8,084.31 万元，占营业收入比例为 13.44%。公司围绕高速率、大功率、高可靠性方向开展系统性技术升级，强化研发成果向产业化转化的效率，提升核心技术竞争力。

电信市场领域，对原有的 2.5G、10G 的 DFB、EML 产品持续加强生产过程管控，借以提升产品的良率和稳定性。随着无线和 10G PON 光纤接入部署逐步进入成熟期，行业需求增长放缓。公司在此背景下，积极配合海内外设备商提前布局下一代 25G/50G PON 所需 DFB/EML 产品，此应用需根据不同的上下行要求对应不同芯片规格，公司具备和客户一同推进方案开发的先发优势，在良好的产品匹配度下，已实现批量发货，为把握未来电信市场增长机遇奠定了坚实的基础。

数据中心领域，随着人工智能的快速发展，光模块正加速向高速率演进，逐步从 400G/800G 向 1.6T 等更高速率发展。报告期内，公司的 CW 70mW 激光器产品实现大批量交付，并逐步优化工艺水平。该产品采用非制冷设计，具备高功率输出和低功耗特性，适用于数据中心高速场景，成为公司新的增长极。公司推出的 CW 100mW 激光器产品，在同样具备高可靠性的前提下，报告期内也实现批量交付。2025 年，公司在可插拔的硅光光模块领域，以 70mW 的光源需求为主。公司的高速 EML 产品，在 100G PAM4 EML 产品完成客户验证的基础上，更高速率的

200G PAM4 EML 产品也开始推进客户验证。

与此同时，CPO/NPO 等新型封装技术通过高度集成实现了更高的带宽密度和更低的功耗，被视为 1.6T 及以上速率的解决方案之一。公司瞄准这一机遇，研发了 300mW 等更高功率的 CW 光源，目前正在进一步了解客户需求来完善产品的相关研发工作。针对 OIO 领域的 CW 光芯片需求，公司已开展相关预研工作。

2026 年，公司将进一步优化生产制造体系，重点围绕产能扩张、技术升级、自动化提升、生产管理等方面展开：通过光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的实施，加大对核心设备进行采购，稳步扩大产能，提升高端激光器芯片制造产能；在制程工艺方面，稳定现有制程，开发新工艺，搭建下一代工艺制造平台；继续提升制造和检测自动化水平，保证制程稳定，提升生产效率；加强数字化管理能力，全面升级智能制造管理系统；提升人员制造管理水平，通过加强部门协同，精细化工序管理，提升交付能力及效率，并进一步优化库存管理；进一步完善全球化产能布局，有序推进海外建厂工作。

## **2、加强人才队伍建设，优化人才激励机制**

人才是公司的核心，公司持续推进人才队伍建设，在业务拓展的同时，注重人才引进和培养。公司通过校园招聘、社会招聘、内部推荐及晋升等多种渠道，积极引进行业资深人员与优秀毕业生，2025 年度员工人数稳步增长，为市场拓展和业绩提升提供了有力保障。同时，公司致力于为员工提供公平、公正的竞争环境与可持续发展平台，重视现有员工的培训与能力提升，加强专业技能和综合素质培养，结合内部晋升机制，为优秀、高潜员工提供成长通道，持续优化人才结构，以适应公司业务发展的需要。通过持续的人才储备，为公司长期发展巩固基础。

2026 年，人才是公司实现高质量、可持续发展的核心资源。公司结合行业技术迭代速度与全球化竞争格局，制定了人才发展规划。紧扣核心技术研发与产业化战略目标，打造与企业发展相匹配的高素质、专业化人才队伍，构建“基础研究-应用开发-量产转化”全链条人才梯队，为公司持续技术突破与市场拓展提供坚实人才支撑。

未来，公司将持续致力于人才队伍的建设与优化，以战略眼光布局人才，以

创新机制激活人才，以产业需求锤炼人才，最终实现“人才领先-技术突破-市场领先”的良性循环。重点培养技术领军人才，持续扩充研发团队，打造一支兼具技术创新能力、产业化落地能力的人才队伍，为公司实现长期可持续发展筑牢人才根基。加强对员工的关怀和激励，鼓励员工敢于创新和挑战，通过坚实的人力资源基础，支撑公司在技术创新与市场竞争中行稳致远。

### **3、推进募投项目建设，提升生产制造水平**

2025年，在全球算力设施建设进程加速的背景下，数据中心的需求与升级持续深化，带动数据传输量的爆发式增长，进而推动全球光模块及光芯片市场规模的快速增长。为了抓住市场机遇，满足客户对多样化产品的需求，公司进一步加大对“50G光芯片产业化建设项目”的投资力度，积极推动产品线从传统电信市场的DFB产品逐步向数据中心领域产品转型。

在投资规模和资金安排方面，经过董事会和股东会审议，公司于2025年3月调整“50G光芯片产业化建设项目”的投资规模，将其总投资从1.29亿元调增至4.87亿元。同时，公司将“10G、25G光芯片产线建设项目”的节余募集资金8200万元和部分超募资金2.75亿元用于前述“50G光芯片产业化建设项目”的投资。目前该项目正在稳步推进中，其中，2025年投入金额约为3.75亿元。截至2025年12月末，累计投入金额约为4.60亿元。

为了满足市场持续增长的需求，在前述投资安排的基础上，公司于2026年初进一步调增原募投项目的建设，同时启动“光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目”的建设工作，该项目计划总投资约12.5亿元。

### **4、加强重点客户拓展，推进海外市场布局**

2025年，公司积极布局海外市场，深入分析目标市场需求，持续拓展重点客户，选派优秀工程师赴美国、德国等地进行技术交流，不断提高产品质量和服务水平，凭借差异化产品满足客户多元需求。同时，公司积极参加国际展览会及研讨会，充分展示公司的产品和技术优势。

为持续推进公司国际化战略及全球化布局，搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司于2025年11

月 19 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。并于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 3 月 23 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。

2026 年，公司把握光芯片市场的发展契机，密切关注市场需求的发展动态，持续加强市场开拓力度，以自主光芯片核心能力构建的技术实力为驱动，积极拓展下游客户，稳固并提升公司的行业地位。面向 PON 市场、无线市场、数通市场几大应用市场开展业务。在目前需求发展较快的数据中心市场，公司立足于已经进入国内外主流客户体系的基础，把握人工智能带来的市场机遇，将持续投入资源加强销售体系建设，提升整体营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化的服务和解决方案。此外，为公司未来拓展其他客户做好充足准备，公司定期对营销和技术服务人员进行培训，内容包括产品及技术参数理解、销售专业技能、客户技术服务等。同时，关注新的技术方向可能带来的行业变化，加强产业链内生态伙伴的合作，把握市场机遇。

## 二、 优化产品结构，提高经营和风险管理水平

公司根据市场需求，积极推动产品线从传统电信市场的 DFB 产品逐步向数据中心领域的 CW 光源等高功率、高速率产品转型。2025 年，公司在持续深耕电信市场的基础上，积极把握 AI 发展带来的数据中心市场机遇。随着公司在 CW 光源等产品实现了规模性销售，2025 年度，公司数据中心业务收入实现收入 3.93 亿元，较上年同期上升 719.06%。从产品结构来看，数据中心业务占营业收入比例高达 65.39%，数据中心业务已成为公司第一大业务。

在产能支持方面，公司依托“50G 光芯片产业化建设项目”募投项目，在产线设计中兼容 50G、100G、CW 光源等多种高速率光芯片的生产标准要求。面对人工智能领域持续增长的市场需求，公司于 2025 年 3 月调增该项目的投资规模，同时也加大主要设备的购置力度。在运营管理方面，面对市场需求大幅增长和产

品结构变化，公司在生产安排进行积极的调整，运营效率也大幅提升。2025年，公司的存货周转率为1.97，相对于2024年同比提高54.01%。

应收账款管理方面，随着公司业务规模的提高，公司仍持续增强风险意识，加大了应收账款的管理。2025年，公司应收账款周转率和应收账款结构均大幅改善，应收账款周转率从2024年2.28提高至2025年3.12。应收账款的结构也进一步优化。截至2025年末，1年以上的应收账款占比从期初的5.20%进一步下降至0.99%。

在研发费用投入方面，按照年初制定的经营策略，公司在年内继续加大大功率CW、EML等高功率和高速率芯片的研发投入，2025年研发费用为8084.31万元，同比增加48.29%。在持续的研发投入下，公司的产品结构进一步优化，数据中心在主营业务的占比逐步提高。

### **三、完善公司治理，实现高质量发展**

公司严格遵守法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，完善公司法人治理结构，加强公司内部控制体系建设，规范公司运作，提升决策水平。

#### **1、关注政策变化，完善公司治理制度**

2025年，公司全面贯彻落实最新法律法规要求，结合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度进行系统修订，确保制度有效运行，提升公司治理水平。同年6月，公司取消设置监事会及监事，原职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止。

2026年，公司将进一步跟进法律法规及监管政策动向，动态优化治理制度体系，推动各项规则有效落地执行。通过持续完善治理架构、提升规范运作水平、强化“关键少数”的合规意识，不断夯实治理基础，为公司高质量发展提供有力支撑。

#### **2、完善内控体系建设，保障公司稳健运营**

2025年，公司以《内部审计制度》为依据，以各部门管理制度为支撑，紧

密结合经营管理实际，开展内部审计工作。通过复盘内控体系执行情况和 IT 化系统全程跟踪业务流转全流程，排查流程规范性、合理性存在的问题，针对性制定改进措施，持续健全内部控制制度、优化业务流程，保障公司合规运营。

2026 年，公司将持续推进内控体系并优化、修订。内部审计部门定期对各部门、全业务环节，开展全覆盖内控审计及评价，如研发、固定资产等业务循环的业务流程规范性、制度执行有效性等关键领域。针对审计发现问题，第一时间出具专项审计报告，清晰界定问题症结、归根问题溯源、明确整改方向，并跟踪整改落实进度。通过内控审计，形成全审计闭环的流程机制，以高效内控体系促进公司稳健运营，为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。

### **3、重视“关键少数”，推动可持续发展**

2025 年，公司共召开股东会会议 4 次，董事会会议 14 次、独立董事专门会议 2 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 2 次。公司通过高效有序的会议机制，充分发挥“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续提升规范运作水平和科学决策能力，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，及时传递监管政策动态，不断提升履职能力，强化合规意识，推动公司治理水平持续优化。

2026 年，公司将继续秉持“重视‘关键少数’、推动公司可持续发展”的理念，密切跟踪监管政策变化，及时传达最新监管要求，持续强化“关键少数”的合规意识与履职规范。公司将依托各类培训平台，组织董高参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平，为公司可持续发展提供坚实保障。

### **4、强化“关键少数”责任，风险共担及利益共享约束**

2025 年，公司持续推进长效激励约束机制建设，有序实施 2024 年限制性股票激励计划预留授予工作。2025 年 7 月 28 日，公司向 191 名 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予 11.43 万股限制性股票。2025 年 10 月 22 日，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，符合激励条件的激励对象 163 人完成了 17.6980 万股限制性股票的归属。

同时，公司启动 2025 年限制性股票激励计划，于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。2025 年 9 月 15 日，该计划经 2025 年第三次临时股东会审议通过。同日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 324 名 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予 50.76 万股限制性股票，授予价格为 149.09 元/股。

上述激励计划的实施，旨在进一步完善公司治理结构，吸引和留住核心人才，充分调动管理人员及骨干员工的积极性与创造性，将股东、公司和核心团队三方利益紧密结合，共同关注公司长远发展，为实现发展战略和经营目标提供有力保障。

2026 年，公司将严格按照相关法律法规及激励计划的规定，稳步推进激励计划的各项实施工作，持续增强员工归属感和团队凝聚力，推动员工利益与公司长期发展深度绑定，为公司高质量发展注入持久动力。

#### **四、提升信披水平，加强投资者沟通**

公司始终秉承“以投资者为中心”的理念，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

##### **1、提升信披水平，加强投资者沟通**

2025 年，公司召开了年度、半年度、季度，共 4 次业绩说明会。并通过价值在线平台线上召开年度、半年度、季度业绩交流会，由董事长、总经理等管理层亲自出席，就经营成果、财务状况等投资者关注的问题进行深入解读与交流，积极回应市场关切，有效增强投资者信心，提升信息披露透明度。

2026 年，公司将在定期报告披露后安排不少于 3 场业绩说明会，继续遵循合规、平等、主动、诚实守信的原则，充分拓展上交所“e 互动”平台、投资者邮箱、投资者热线、线上及线下交流会、股东会等多元化沟通渠道，为投资者提供便捷畅通的沟通途径，加深投资者对公司生产经营、战略布局、创新能力等方面的了解，增进投资者认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信

赖的关系，不断巩固市场信心。

## **2、提高信息披露透明度，增强投资者信心**

2025年，公司持续优化信息披露方式，通过“一图读懂”、可视化报告等创新形式，生动呈现公司的经营成果、财务状况及发展战略，提升定期报告的可读性与传播效果。同时，公司结合行业政策与市场动态，对所从事的主要业务、经营模式、核心竞争力、研发进展等情况进行详细说明，帮助投资者全面了解公司基本面与发展方向。

2026年，公司将继续提升信息披露质量与透明度，进一步优化披露内容，增强信息传递的有效性，将公司价值传递给资本市场，推动投资者对公司形成更全面、深入的认识，不断巩固投资者的信任与支持。

## **五、以投资者为本，提高投资者回报**

公司坚持以投资者为本的原则，建立“长期、稳定、持续”的股东价值回报机制，不断增强投资者信心，建立长期的信任。

### **1、持续现金分红，注重投资者回报**

公司重视对投资者的回报，在确保公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的前提下，制定合理的利润分配方案，以实质回报投资者。

在回报投资者方面，公司实行持续、稳定的利润分配政策。2025年，公司制定并实施了2024年年度利润分配方案及2025年半年度利润分配方案，以合理的现金分红落实对投资者的回报承诺，维护其合法权益。同时，为进一步完善公司的利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2026年，公司计划拟实施2025年年度权益分派，公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2026年3月23日，公司总股本85,947,726股，扣除目前回购专户的股份余额275,169股后参与分配股数共85,672,557股，

以此计算合计拟派发现金红利 59,970,789.90 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利 25,648,673.10 元）总额 85,619,463.00 元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 44.84%。

同时，公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股。截至 2026 年 3 月 23 日，公司总股本 85,947,726 股，本次转增股后，公司的总股本为 124,500,377 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入所致）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 275,169 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

2026 年，公司为增强广大投资者的获得感，提高投资者回报力度，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。并提请股东会授权公司董事会，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。

## **2、回购助推激励，夯实市场信心**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步建立健全公司长期激励机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致，实现收益共享。

截止 2025 年 2 月，公司完成了回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 452,149 股，回购成交的最高价为 125.00 元/股，最低价为 105.97 元/股，回购均价 122.55 元/股，支付的资金总额为人民币 55,409,350.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将持续评估并扎实推进“提质增效重回报”各项举措，努力通过以稳健的业绩表现、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任，回馈投资者信任，维护公司股价长期稳定。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成对投资者的实

质承诺，敬请投资者理性投资，注意风险。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月23日